

【11】 證書號數：M485114

【45】 公告日：中華民國 103 (2014) 年 09 月 01 日

【51】 Int. Cl. : B23Q17/24 (2006.01) G05B19/404 (2006.01)

新型

全 5 頁

【54】 名 稱： 用於鑄花工件量測的智慧型手持設備

【21】 申請案號： 103206099 【22】 申請日： 中華民國 103 (2014) 年 04 月 09 日

【72】 新型創作人： 蔡沛原 (TW)；黃韋倫 (TW)；簡志賢 (TW)；沈建華 (TW)；蘇春榮 (TW)；周永如 (TW)

【71】 申請人： 財團法人精密機械研究發展中心
臺中市西屯區工業區三十七路 27 號

【74】 代理人： 黃志揚

[57]申請專利範圍

1. 一種用於鑄花工件量測的智慧型手持設備，用於量測一鑄花工件的一表面鑄花紋路，以取得該表面鑄花紋路的承斑點數，該智慧型手持設備包含：一影像擷取元件，該影像擷取元件為拍攝該表面鑄花紋路而產生一影像資料；一顯示元件；以及連接該影像擷取元件與該顯示元件的一運算處理元件，該運算處理元件為接收該影像資料，且經由影像辨識處理運算後得知該表面鑄花紋路的承斑點數，並直接由該顯示元件顯示該表面鑄花紋路的承斑點數。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之用於鑄花工件量測的智慧型手持設備，其中更包含連接該運算處理元件的一比對單元，該比對單元供設定預定的承斑點數，且該比對單元比對預定的承斑點數與該運算處理元件運算後得知的承斑點數，並提供一比對結果。
3. 如申請專利範圍第 2 項所述之用於鑄花工件量測的智慧型手持設備，其中該比對結果為不符合時，該運算處理元件經過運算後，透過該顯示元件顯示該表面鑄花紋路需要再鑄花修正的區域。
4. 如申請專利範圍第 1 項所述之用於鑄花工件量測的智慧型手持設備，其中該影像擷取元件為連續拍攝該表面鑄花紋路而產生複數連拍影像資料，該運算處理元件為接收該複數連拍影像資料，並透過一連拍均勻化單元均勻化該複數連拍影像資料的亮度後，再經由影像辨識處理運算得知該表面鑄花紋路的承斑點數。
5. 一種用於鑄花工件量測的智慧型手持設備，用於量測一鑄花工件的一表面鑄花紋路，以取得該表面鑄花紋路的承斑面積比，該智慧型手持設備包含：一影像擷取元件，該影像擷取元件為拍攝該表面鑄花紋路而產生一影像資料；一顯示元件；以及連接該影像擷取元件與該顯示元件的一運算處理元件，該運算處理元件為接收該影像資料，且經由影像辨識處理運算後得知該表面鑄花紋路的承斑面積比，並直接由該顯示元件顯示該表面鑄花紋路的承斑面積比。
6. 如申請專利範圍第 5 項所述之用於鑄花工件量測的智慧型手持設備，其中更包含連接該運算處理元件的一比對單元，該比對單元供設定預定的承斑面積比，且該比對單元比對預定的承斑面積比與該運算處理元件運算後得知的承斑面積比，並提供一比對結果。
7. 如申請專利範圍第 6 項所述之用於鑄花工件量測的智慧型手持設備，其中該比對結果為不符合時，該運算處理元件經過運算後，透過該顯示元件顯示該表面鑄花紋路需要再鑄花修正的區域。

(2)

8. 如申請專利範圍第 5 項所述之用於鍍花工件量測的智慧型手持設備，其中該影像擷取元件為連續拍攝該表面鍍花紋路而產生複數連拍影像資料，該運算處理元件為接收該複數連拍影像資料，並透過一連拍均勻化單元均勻化該複數連拍影像資料的亮度後，再經由影像辨識處理運算得知該表面鍍花紋路的承斑面積比。

圖式簡單說明

圖 1，為本創作智慧型手持設備立體結構圖。

圖 2，為本創作智慧型手持設備另一角度立體結構圖。

圖 3，為本創作智慧型手持設備系統方塊圖。

圖 4，為本創作使用示意圖。

圖 5，為本創作另一實施方式系統方塊圖。

圖 6，為本創作另一實施方式流程圖。

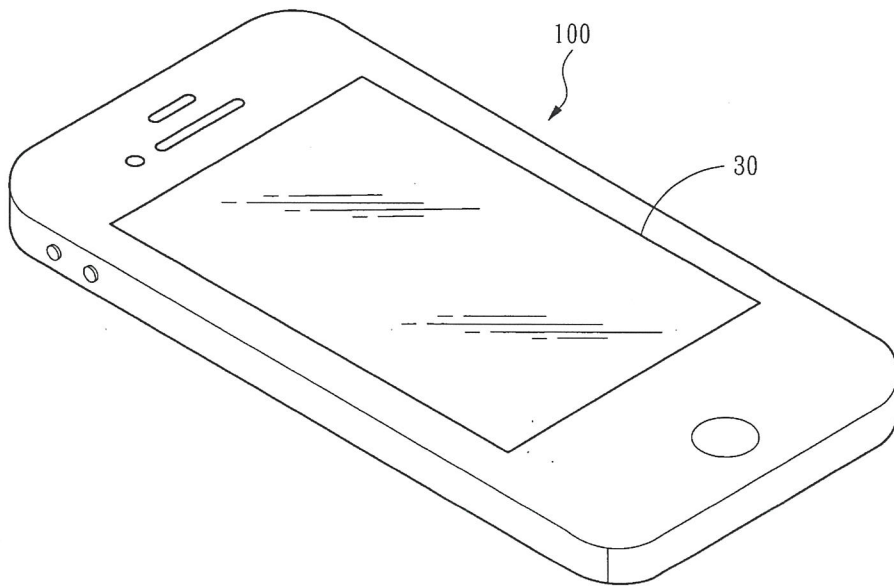


圖 1

(3)

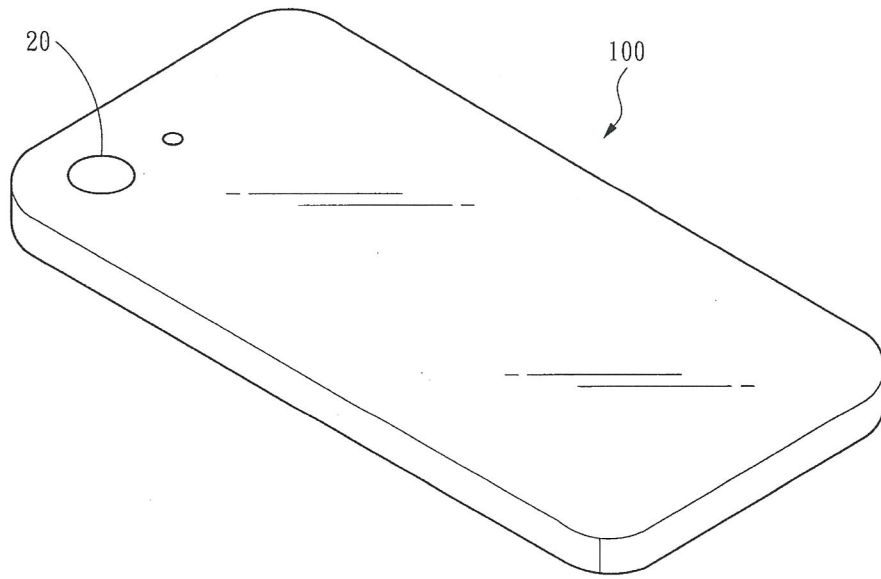


圖 2

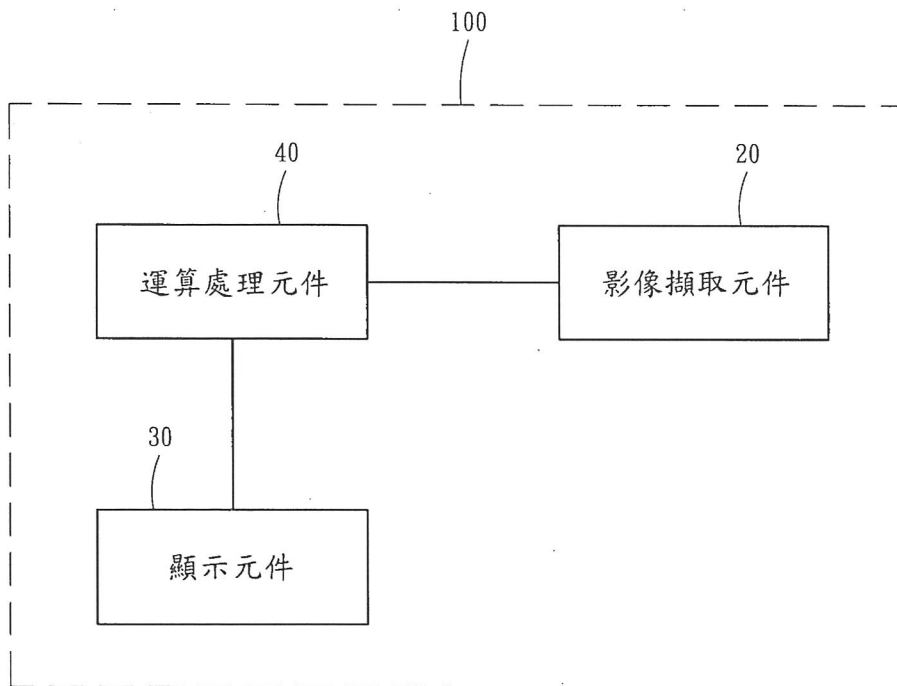


圖 3

(4)

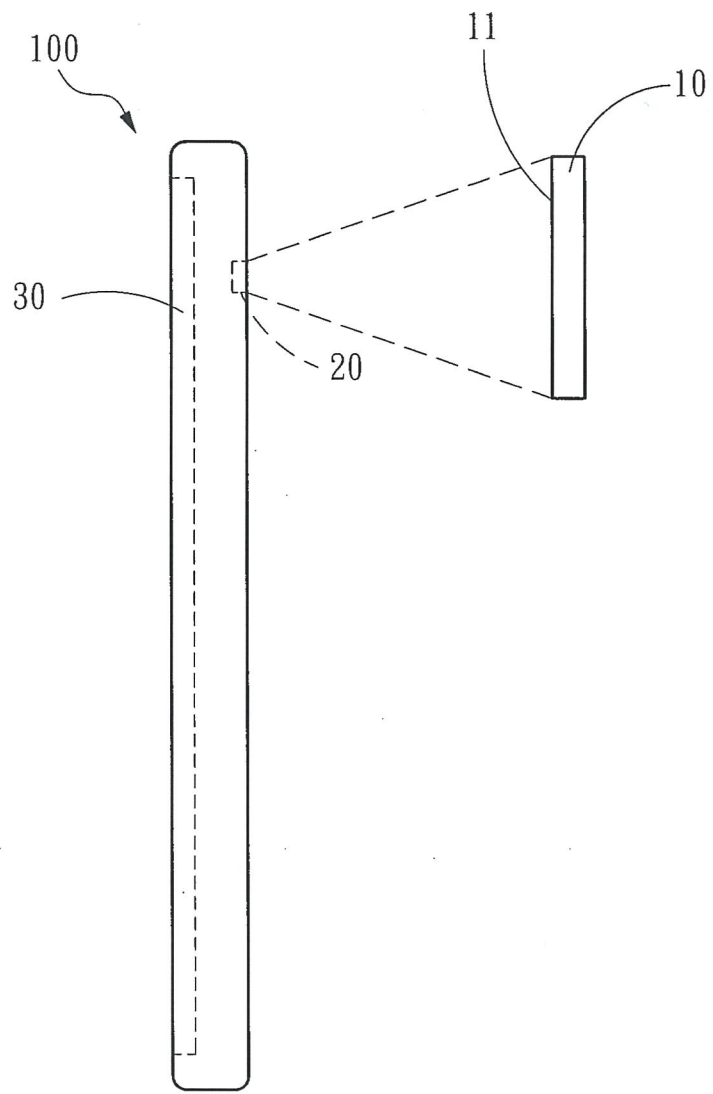


圖 4

(5)

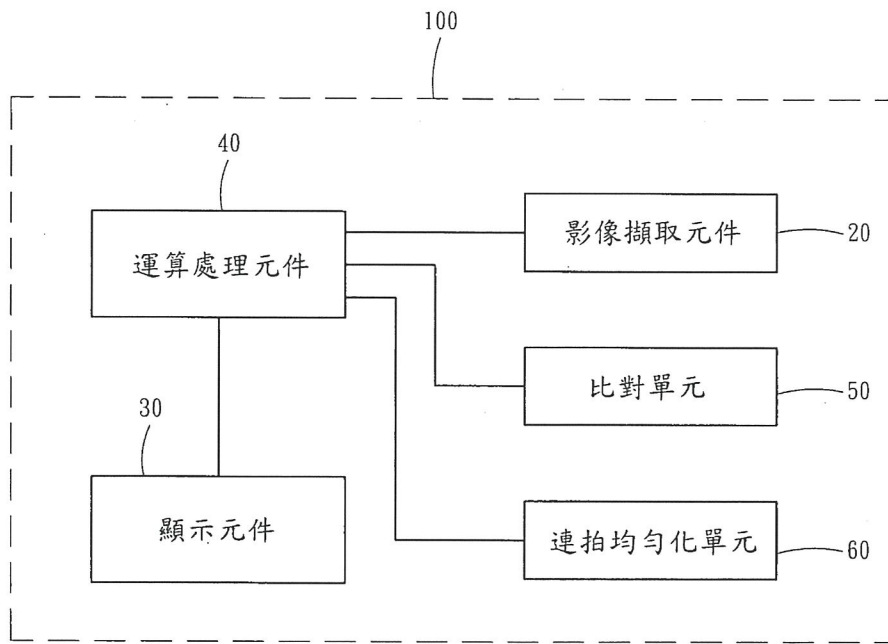


圖 5

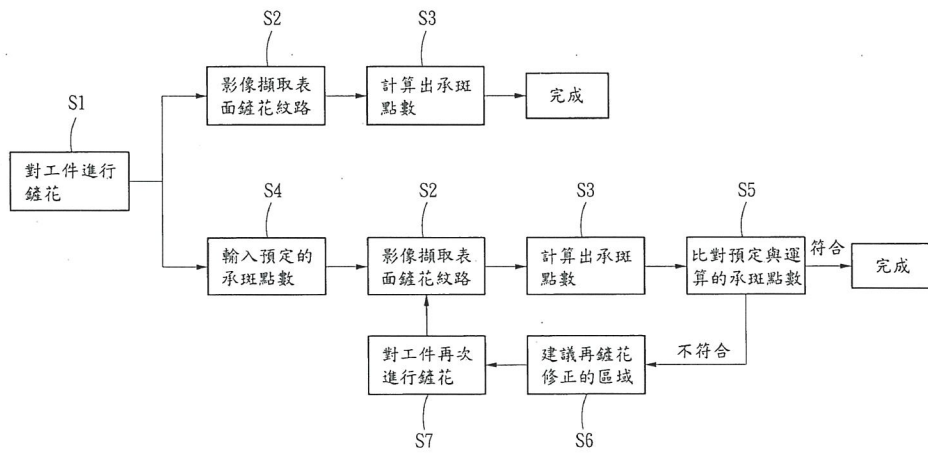


圖 6